

KAH7カバーテープ テクニカルレポート

目次

- 製品紹介
- カバーテープの構造
- 特徴

製品紹介

KAHカバーテープは3枚のフィルムの層から構成されており、上段はポリエステル基本構造フィルム、中段はオレフィンフィルム、上段は加熱活性化接着剤の層となっています。

また下段は、静電気に弱いデバイスの保護を目的として静電気拡散仕様となっています。

II. Cover Tape Structure



特徴

1. 市場に流通している主要なキャリアテープとの互換性。
2. 幅広いヒートシール温度及び耐圧適応性。
3. 様々なテープ脱着工程及び条件に対応できる優れた材料特性。
4. 各種使用経過状況に対し、誤差を最小限に抑える安定したPOS性能。
5. 環境への配慮。
6. 高い破断耐性。
7. 優れた透明度。